

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 26 年 4 月 24 日 (2014.4.24)

【公開番号】特開 2012-212712 (P2012-212712A)

【公開日】平成 24 年 11 月 1 日 (2012.11.1)

【年通号数】公開・登録公報 2012-045

【出願番号】特願 2011-76410 (P2011-76410)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/60 3 2 1 E

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 3 月 10 日 (2014.3.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基材上の一部に形成されている配線層と、前記配線層の一部である複数のパッド部を囲むように形成されているレジスト層と、を有する配線基板と、

前記複数のパッド部の一方の上に電氣的に接続するように設けられている半導体装置と

、

前記複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と、

前記半導体装置の上に設けられている接合材と、

前記複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と、前記半導体装置の上に設けられている接合材と、に接するように設けられている接続部材と、

を有し、

前記接続部材は、前記複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と接する第 1 の接合部材と、

前記半導体装置の上に設けられている接合材と接する第 2 の接合部材と、

前記第 1 の接合部材と前記第 2 の接合部材と一定の間隔を設けて形成されている第 1 の部材と、

前記第 1 の部材を支持し、前記第 1 の接合部材と接続している第 2 の部材と、

前記第 1 の部材を支持し、前記第 2 の接合部材と接続している第 3 の部材と、

を有することを特徴とする半導体装置の実装構造。

【請求項 2】

前記接続部材は、板状であることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置の実装構造。

【請求項 3】

前記第 3 の部材の長さは、前記第 1 の接合部材と前記第 2 の接合部材の厚みの合計よりも長いことを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の半導体装置の実装構造。

【請求項 4】

前記第 1 の部材は前記基材と略平行となるように設けられていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 に記載の半導体装置の実装構造。

【請求項 5】

前記第 2 の部材の長さと前記第 3 の部材の長さは異なることを特徴とする請求項 1 乃至

請求項 4 に記載の半導体装置の実装構造。

【請求項 6】

基材上の一部に形成されている配線層と、前記配線層の一部である複数のパッド部を囲むように形成されているレジスト層と、を有する配線基板と、前記複数のパッド部の一方の上に電氣的に接続するように半導体装置を設ける工程と、

前記複数のパッド部の他方の上と、前記半導体装置の上に接合材を設ける工程と、

前記複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と、前記半導体装置の上に設けられている接合材と、に接するように接続部材を設ける工程と、

を有し、

前記接続部材は、前記複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と接する第 1 の接合部材と、前記半導体装置の上に設けられている接合材と接する第 2 の接合部材と、前記第 1 の接合部材と前記第 2 の接合部材と一定の間隔を設けて形成されている第 1 の部材と、前記第 1 の部材を支持し、前記第 1 の接合部材と接続している第 2 の部材と、前記第 1 の部材を支持し、前記第 2 の接合部材と接続している第 3 の部材を含むことを特徴とする半導体装置の実装方法。

【請求項 7】

前記第 1 の部材は前記基材と略平行となるように設けることを特徴とする請求項 6 に記載の半導体装置の実装方法。